

# 公開実用 昭和64-44640

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報(U)

昭64-44640

⑬ Int.Cl.<sup>4</sup>

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和64年(1989)3月16日

H 01 L 23/32  
H 01 R 33/76  
H 05 K 1/18

A-8728-5F  
6749-5E  
T-6736-5F

審査請求 未請求 (全 頁)

⑮ 考案の名称 ICの実装装置

⑯ 実 願 昭62-139702

⑰ 出 願 昭62(1987)9月11日

⑱ 考 案 者 松 葉 研 児

埼玉県入間市大字上藤沢字下原480番地 株式会社安川電  
機製作所東京工場内

⑲ 出 願 人 株式会社安川電機製作  
所

福岡県北九州市八幡西区大字藤田2346番地

⑳ 代 理 人 弁理士 今井 義博



(1)

明 細 書

1 考案の名称

ICの実装装置

2 実用新案登録請求の範囲

基板上に取り付けたICソケットと、このICソケットに挿入したICを設け、前記ICと基板との空間に他の実装部品を設けたことを特徴とするICの実装装置。

3 考案の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本案は、プリント基板に取り付けられるICその他の実装装置に関する。

〔従来技術とその問題点〕

従来、プリント配線板に実装されるICその他の部品は、基板の実装面に直接、平面状に配置され、したがって配置スペースが不足すると、複数の基板に分割して実装する。

したがって、基板の数が増え、基板の保持と、相互の接続が面倒になるだけでなく、実装部品相互のプリント導線も長くなる欠点がある。

実開 64-44640

424



(2)

〔問題点を解決するための手段〕

この考案は、上記の欠点を解決するため、大形のICをICソケットによって基板から離して実装させ、このICと基板との空間を利用して、他の小形のICや部品を実装させ、実装面積を拡大するとともに、前記ICと関連する部品との実装距離を小さくできるようにしてある。

〔作用〕

実施例を示す図面に基づいて説明する。

1は基板、2・2はこの基板の実装面に取り付けられたICソケットで、適宜の高さでその上面にピン孔3をそなえている。4はIC、5はそのピン、6は前記IC4より小形のICなどの部品、7は従来と同様に実装された部品である。

基板1の実装面にICソケット2が取り付けられ、その間のスペースに他の部品6を実装配置する。ICソケット2はその上面にピン孔3をそなえ、このピン孔3にピン5を挿入してIC4を前記部品6の上にかぶせて配置する。

なお、ICソケット2・2間に実装される部品



(3)

6は、実施例で示した小形のICに限られず、抵抗、コンデンサなどでもよく、IC4と干渉しないようにしておけばよい。

考案  
〔発明の効果〕



このように本考案によれば、基板面積を有効に利用することができ、基板サイズの縮小または基板枚数を減少させることができる。また、基板のパターン設計においてバスラインの短縮化を行うなどの効果がある。

#### 4 図面の簡単な説明

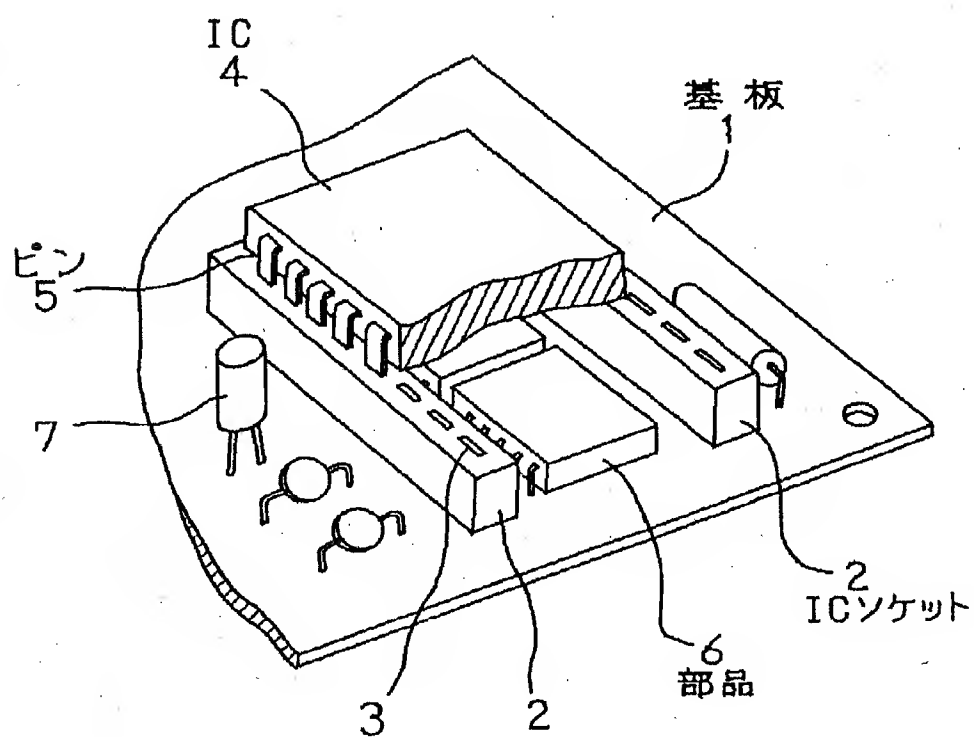
図は本考案の実施例を示す斜視図で一部を切り欠いである。

1は基板、2はICソケット、4はIC、6は部品である。

代理人 弁理士 今 井 義



公開実用 昭和64-44640



代理人 弁理士 今井 義博

実用 64-44640